

2024年9月4日
住友電気工業株式会社

ECOC Exhibition 2024 に出展

住友電気工業株式会社（本社：大阪府中央区、社長：井上 治、以下「当社」）は、2024年9月23日～25日にドイツ・フランクフルトで開催される「European Conference on Optical Communication (ECOC) Exhibition 2024（以下、本展示会）」に出展し、高速大容量通信を実現する最先端の情報通信関連製品・技術、ソリューションをご紹介します。



主要展示製品

Z-PLUS Fiber™ 超低損失マルチコアファイバ

当社は、陸上用途、海底用途などさまざまなマルチコアファイバ（MCF）の研究開発を進め、昨年世界で初めて量産を実現しました。海底用途向けに設計された2心ファイバは、本展示会のインダストリー・アワード2024の最優秀ファイバ・コンポーネント製品部門の候補に選出されています。

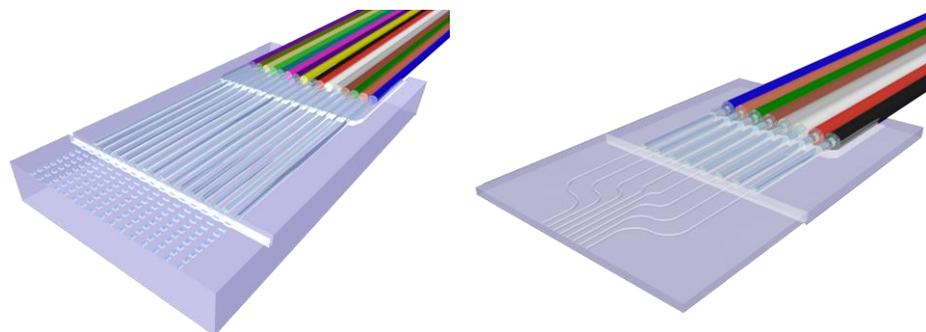


高精細 コア調心型融着接続機

AI 技術で最適な融着接続条件に自動で調整する「NanoTune®」により作業スピードの向上、低損失／高品質な融着接続を可能にしました。また、現場とオフィスのタイムリーな情報共有をクラウドサービスの活用により実現するIoT 技術「SumiCloud®」を搭載し、融着接続データの蓄積や融着機の状態検知による耐久性向上を実現しました。



柔軟なカスタマイズが可能な光ファイバと PIC（フォトニック IC）間の結合技術を有する光ファイバアレイ



データセンタ内で、光ファイバの高密度収納を実現するソリューションの一つとして開発された光ファイバアレイ。光ファイバと PIC 間のシームレスで高性能な相互接続を確立し、シリコンフォトニクス（光信号を用いて情報を処理・転送する技術）の効率と信頼性を高めるだけでなく、システム全体の設計最適化に貢献します。

InP（インジウムリン）をベースとしたチップ技術

高出力 CW（Continuous Wave：連続波）レーザーチップやレーザーダイオード（Electro-absorption Modulator integrated Laser diode、EML）など、InP 半導体チップを活用した様々な光半導体デバイスを展示します。



ECOC は、光通信に特化した欧州最大級の国際会議・展示会で、世界中から 3,000 社以上の出展者と 6,500 人を超える来場者が集まります。

News Release



当社ブースへの皆様のご来場を心よりお待ちしております。

当社出展概要

期間	2024年9月23日(月)～25日(水)
会場	フランクフルト・メッセ(ドイツ)
ブース番号	A118
公式サイト	https://www.ecocexhibition.com/
主要展示製品	光半導体デバイス、光ファイバ、融着接続機、光ファイバアレイ

以上